

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 4 月 3 日(03.04.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/050371 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 67/04 (2006.01) *C08K 7/02* (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/072226
- (22) 国際出願日: 2013 年 8 月 20 日(20.08.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-212179 2012 年 9 月 26 日(26.09.2012) JP
特願 2012-212180 2012 年 9 月 26 日(26.09.2012) JP
- (71) 出願人: ポリプラスチック株式会社 (POLY-PLASTICS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1088280 東京都港区港南二丁目 1 8 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 深津 博樹(FUKATSU, Hiroki); 〒4168533 静岡県富士市宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP). 大竹 峰生(OHTAKE, Mineo); 〒4168533 静岡県富士市宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP). 龍 和博(RYU, Kazuhiro); 〒4168533 静岡県富士市宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP). 杉浦 淳一郎(SUGIURA, Junichiro); 〒4168533 静岡県富士市宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内

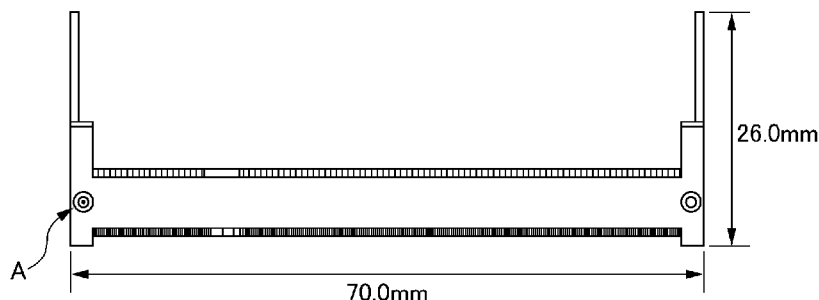
Shizuoka (JP). 田口 吉昭(TAGUCHI, Yoshiaki); 〒4168533 静岡県富士市宮島 9 7 3 番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 正林 真之, 外(SHOBAYASHI, Masayuki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内 1 - 7 - 1 2 サビアタワー Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシヤ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: COMPOSITE RESIN COMPOSITION FOR ELECTRONIC COMPONENT AND ELECTRONIC COMPONENT MOLDED FROM COMPOSITE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 電子部品用複合樹脂組成物、及び当該複合樹脂組成物から成形された電子部品



(57) Abstract: The objective of the present invention is to provide a composite resin composition for electronic components which has excellent fluidity and an electronic component molded from the composite resin composition. The present invention provides a composite resin composition for electronic components comprising (A) a liquid crystal polymer, (B) milled fiber and (C) a plate-like inorganic filler, wherein (A) the liquid crystal polymer includes, as essential components, (I) a constitutional unit derived from a 4-hydroxybenzoic acid, (II) a constitutional unit derived from a 2-hydroxy-6-naphthoic acid, (III) a constitutional unit derived from a terephthalic acid, (IV) a constitutional unit derived from an isophthalic acid and (V) a constitutional unit derived from a 4,4'-di-hydroxybiphenyl.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2014/050371 A1



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

流動性が良好である電子部品用複合樹脂組成物、及び当該複合樹脂組成物から成形された電子部品を提供すること。本発明は、(A)液晶性ポリマーと、(B)ミルドフアイパーと、(C)板状無機充填材と、を含む電子部品用複合樹脂組成物であって、上記(A)液晶性ポリマーは、必須の構成成分として、下記の構成単位：(1) 4-ヒドロキシ安息香酸由来の構成単位、(11) 2-ヒドロキシ-6-ナフトエ酸由来の構成単位、(111) フレニタル酸由来の構成単位、(1V) イソフタル酸由来の構成単位、及び(V) 4, 4'-ジヒドロキシビフェニル由来の構成単位を含む。